SUNYOU

반도체 디바이스 국소 연마기

LOCALIZED POLISHING SYSTEM
ELLMID series



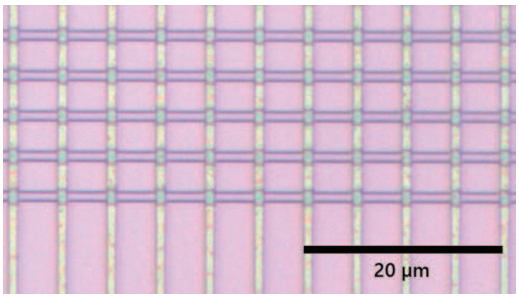
반도체 디바이스의 분석을 위해
특정 부위를 얇고 평탄하게 가공도록
개발된 장비입니다.

단시간에 정밀하며 재현성 높은 가공으로
분석 리드타임을 (Turnaround Time) 단축 !!

제품문의처: 주원프리시젼 T. 031-264-2470

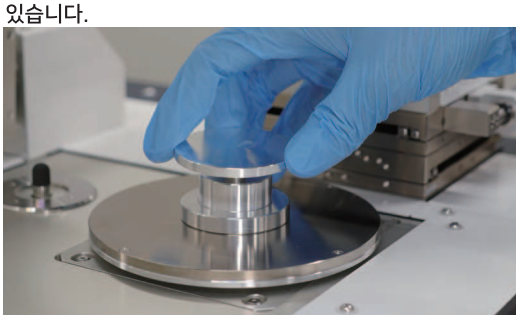
Model
DG300





가공 위치 조정 및 결과를 즉시 확인

관찰장치 일체형이기 때문에, 가공 전 목표 위치를 정밀하게 설정하고, 가공 결과를 한 대의 장비에서 바로 확인할 수 있습니다.



폭넓은 시료 크기에 대응

다양한 크기의 시료에 대응하는 대형 시료대 장착 !
최대 □50㎜ 크기의 시료까지의 가공이 가능합니다.



높은 가공 재현성 실현

세부적인 가공 파라미터를 12세트 저장할 수 있습니다.
저장한 파라미터는 터치패널 위에서 간단히 불러올 수 있어,
누구나 재현성 높은 가공을 실현합니다.

Specifications

모 델	DG300
장치 치수 ※1	500mm(W) × 450mm(D) × 880mm(H) 이하
장치 중량	38kg (본체만)
시료대 회전 속도	1 ~ 100rpm
휠(wheel) 회전 속도	1 ~ 600rpm
탑재 가능 샘플 사이즈	□50mm 이하, 두께 3mm 이하, ※고객의 디바이스 두께에 맞추어 상담 대응
하중 설정	1 ~ 100gf
가공 파라미터 저장 수	12개
소비 전력	최대 330VA (AC220V)
설치 공간	1300mm(W) × 600mm(D) (카메라 유닛 포함) 내하중: 250kg 이상

Options

현미경 유닛 (쌍안 타입) ※3
현미경 유닛 (삼안 타입) ※3 ※4
중간 변배 장치 (1X, 1.25X, 1.6X, 2X)
대물렌즈 10X
대물렌즈 20X
대물렌즈 50X
대물렌즈 100X
카메라 유닛

※1 장치 치수는 카메라 유닛 탑재 시의 본체 치수입니다.
※2 진동이 없는 장소에 설치해 주십시오.
고배율 관찰이 어려워질 수 있습니다.
※3 접안렌즈는 10X 고정입니다.
※4 카메라 유닛을 사용할 때는 삼안 타입을 선택해 주십시오.
(삼안타입: 육안 관찰 및 카메라 영상)

SUNYOU
株式会社 三友製作所
https://www.sunyou-ss.co.jp

Techno Center
2-43-4 Ishinazaka-cho, Hitachi-shi,
Ibaraki 319-1225, Japan
TEL. +81 294-33-9931 FAX. +81 294-33-9932
E-mail info-sale@sunyou-ss.co.jp

제품 문의처 (한국대리점):

주원프리시젼
T. 031-264-2470
www.joowonprecision.com

제품의 사양 및 외관은 품질 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
2024년 5월 현재